

Bruksela, 21 listopada 2018 r.
(OR. en)

14559/18
ADD 1

ENV 797
MI 870
DELECT 153

PISMO PRZEWODNIE

Od:	Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU
Data otrzymania:	19 listopada 2018 r.
Do:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej
Nr dok. Kom.:	C(2018) 7499 final - Annex
Dotyczy:	ZAŁĄCZNIK do dyrektywy delegowanej Komisji zmieniającej, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu w stopach lutowanych służących do zakończenia trwałego połączenia elektrycznego pomiędzy urządzeniem półprzewodnikowym a nośnikiem w ramach obwodów scalonych typu Flip-Chip

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument C(2018) 7499 final - Annex.

Załącznik: C(2018) 7499 final - Annex



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 16.11.2018 r.
C(2018) 7499 final

ANNEX

ZAŁĄCZNIK

do

dyrektywy delegowanej Komisji

zmieniającej, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu w stopach lutowniczych służących do zakończenia trwałego połączenia elektrycznego pomiędzy urządzeniem półprzewodnikowym a nośnikiem w ramach obwodów scalonych typu Flip-Chip

ZAŁĄCZNIK

Załącznik III pozycja 15 otrzymuje brzmienie:

„15	Ołów w stopach lutowniczych służących do zakończenia trwałego połączenia elektrycznego pomiędzy urządzeniem półprzewodnikowym a nośnikiem w ramach obwodów scalonych typu Flip-Chip	Dotyczy kategorii 8, 9 i 11 i wygasa: – dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki <i>in vitro</i> i przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych; – dnia 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki <i>in vitro</i> kategorii 8; – dnia 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych kategorii 9 oraz dla kategorii 11.
15a)	Ołów w stopach lutowniczych służących do zakończenia trwałego połączenia elektrycznego pomiędzy urządzeniem półprzewodnikowym a nośnikiem w ramach obwodów scalonych typu Flip-Chip, gdzie zastosowanie ma co najmniej jedno z poniższych kryteriów: – technologia wytwarzania półprzewodników 90 nm lub większych; – indywidualna struktura półprzewodnikowa o wielkości 300 mm² lub większa wykonana w dowolnej technologii wytwarzania; – zespoły spiętrzonych struktur półprzewodnikowych, gdzie struktura półprzewodnikowa ma wielkość 300 mm² lub większą, lub przekładki krzemowe o wielkości 300 mm² lub większej.	Dotyczy kategorii 1–7 i 10 i wygasa dnia 21 lipca 2021 r.”